

中国国际科学技术合作协会文件

中国国际科学技术合作协会 关于举办 2024 第 18 届中国西安国际科学技术 产业博览会暨硬科技产业博览会的通知

各会员单位：

由陕西省科学技术厅指导，中国国际科学技术合作协会主办，西安市科学技术局组织的 2024 第 18 届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会（简称西安科博会），定于 2024 年 11 月 1 日-3 日在西安国际会展中心举办。

本届西安科博会作为“全球硬科技创新大会”的重要配套活动之一，以“创新驱动发展·科技引领未来”为主题，全面展示高新技术成果、双中心建设成果、硬科技产业、数字化技术与应用、高校创新成果及科普等领域的前沿技术和最新产品，配合主旨论坛、研讨交流会、商务考察等活动，促进政企、行业领域开展多层次、多渠道的交流与合作，推动科技创新与产业发展的深度融合，为构建创新型国家贡献智慧与力量。

请有意向参与举办会期分论坛或相关科技类活动的单位，于 10 月 20 日前联系组委会办公室提出申请；科技企业参展可联系组委会办公室直接报名，并将需要展示的项目推介材料于 10 月

20 日前发送指定邮箱 39337902@qq.com; 参会观众可在大会官网和西安科博会公众号上报名观展。活动详情可查询西安科博会官方网站 <https://www.xakbh.com/> 以了解。

联系人:

中国国际科学技术合作协会

高 雅 (010) 68550603 18210243256

组委会办公室

吕 蒙 (029) 87655324 87655315

中国国际科学技术合作协会

2024 年 8 月 30 日

